

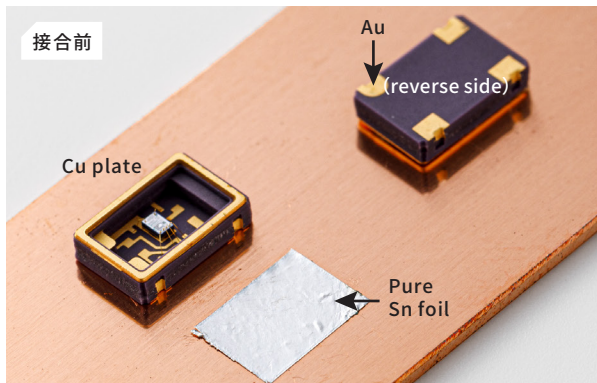


# Application

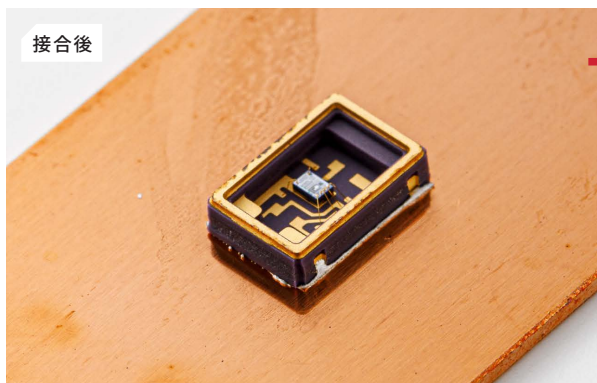
## Bonding ボンディング

# 電子部品と銅板の接合

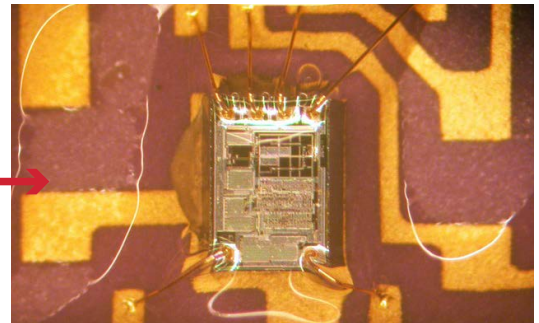
パーツにダメージがない接合と洗浄



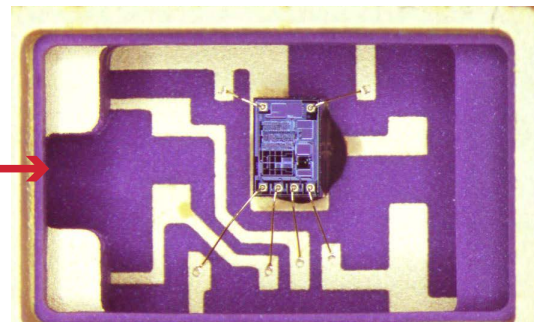
純スズ箔を挟んだ(SAW フィルターと銅板)の接合



スズが拡散しく接合) 直接接合でも可能



アルテックスの装置で洗浄しても  
パッケージにダメージが発生しない



金線の断線無し

**IC パッケージ**  
サウンドパワーでは慣性が発生しないので  
パーツにダメージも発生しない

## Product used 使用する装置

15MZs



AP-J-0104A4-2025041101